

自動挿入工程 生産能力基準

訂正日 2021年 9月7日

作成日 1998年 4月21日

挿入機名 (ディスクリート部品)	自挿可能基板サイズ(mm)		挿入ピッチ(mm)	挿入タクト(秒)	自挿可能 部品寸法			挿入方向	部品種類
	MAX	MIN			リード径(mm)	ボデー径(mm)	ボデー高さ(mm)		
AVK3 高速アキシナル部品 挿入機	508×381	50×50	5~26 (0.01mm単位)	0.2	0.4~1.0 (JWは0.6mm)	—	MAX6mm	4方向 (0,90,180,270)	MAX120
RG131 高密度ラジアル部品 挿入機	508×381	50×50	2.5・5	0.25 (180°)0.45	0.4~0.65	MAX 22.5φ	自挿後の寸法が、 基板面から MAX21mm	4方向 (0,90,180,270)	MAX80

□**メタルマスクの枠**: 基板サイズ330×250(Mサイズ)は**600mm×550mm枠**、左記より大きい基板サイズ(LorLLサイズ)は**736mm×736mm枠**

実装ライン名 (チップ部品)	搬送可能基板サイズ(mm)		装着タクト(秒)		実装可能 部品寸法			装着角度(°)	部品種類
	MAX	MIN	高速機	異形機	MIN	MAX	リード最狭ピッチ		
L6ライン チップ形電子部品 自動装着機	330×250 T上= 30 T下= 15	50×50	0.05~	(2D) 0.3~ (3D) 0.6~	0402~	□55mm 高さ=25mm	・QFP:0.3mm ・BGA:0.5mm	0~359.99° (0.01°単位)	カセット MAX 205 トレイ MAX80
L7ライン チップ形電子部品 自動装着機	330×250 T上= 30 T下= 15	50×50	0.0419~	(2D) 0.3~ (3D) 0.4~	03015~	□45mm 高さ=30mm	・QFP:0.4mm ・BGA:0.3mm	0~359.99° (0.01°単位)	カセット MAX 332 トレイ MAX40
L8ライン チップ形電子部品 自動装着機	330×250 T上= 30 T下= 15	50×50		(認識P) 0.25~ (認識T) 0.4~ リード検 1.4		□50mm 高さ= 15mm	・QFP:0.3mm ・BGA:0.5mm	0~359.99° (0.01°単位)	カセット MAX 60 トレイ MAX80
L9ライン チップ形電子部品 自動装着機	510×390 T上= 30 T下= 15	50×50	0.10~	(認識P) 0.25~ (認識T) 0.4~ リード検 1.4	0603~	□55mm 高さ=25mm	・QFP:0.3mm ・BGA:0.4mm	0~359.99° (0.01°単位)	カセット MAX 210 トレイ MAX80
L10ライン チップ形電子部品 自動装着機	510×330 T上= 30 T下= 15	50×50	0.10~	(2D) 0.18~	0402~	45×100mm 高さ=15mm	・QFP:0.3mm ・BGA:0.5mm	0 ~ ±180° (全0.01°単位)	カセット MAX 252 トレイ MAX15
L11ライン チップ形電子部品 自動装着機	330×250 T上= 30 T下= 15	50×50	0.10~	(2D) 0.18~	03015~	45×45mm 高さ=28mm	・QFP:0.3mm ・BGA:0.5mm	0 ~ ±180° (全0.01°単位)	カセット MAX 128 トレイ MAX10

・実搬送可能基板サイズの「T上下=xx」は、リフロー炉内の搬送面上下通過可能高さ(部品高さ)を表します。